

Pâte thermique COOLP400SI

Code : 10085

Nedis

Seringue de 4 gr de pâte de refroidissement permettant une très bonne dissipation thermique entre un processeur (ou autre composant) et son refroidisseur.

8,25 €_{HT}

9,90 €_{TTC}

Description

Seringue de 4 gr de pâte de refroidissement permettant une très bonne dissipation thermique entre un processeur (ou autre composant) et son refroidisseur.

Cette pâte doit être appliquée en très faible quantité sur le processeur avant l'installation du radiateur. Ce composé semblable à de la graisse ne sèche pas, ne durcit pas et ne fond pas.

- Dosage facile.
- Couleur argent.
- T° de fonctionnement: -30 à 280 °C
- Viscosité: 12500
- Densité: $\geq 3,15$
- Impédance thermique: $\leq 0,0087$ °C-in²/W
- Conductivité thermique: $\geq 4,63$ W/m-k